

MATERIAL:

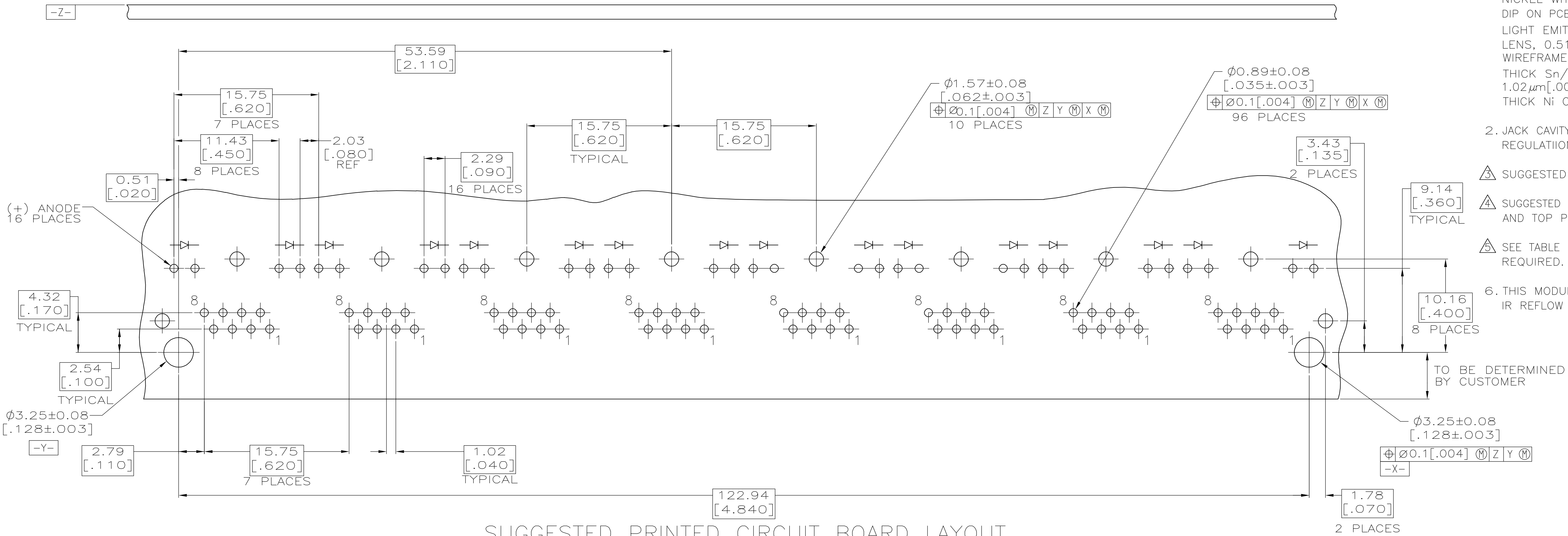
HOUSING - HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK, UL94V-0.

TERMINALS - 0.36[.014] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 3.81µm[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA. 1.27µm[.000050] MINIMUM GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH 1.27µm[.000050] MINIMUM THICK NICKEL.

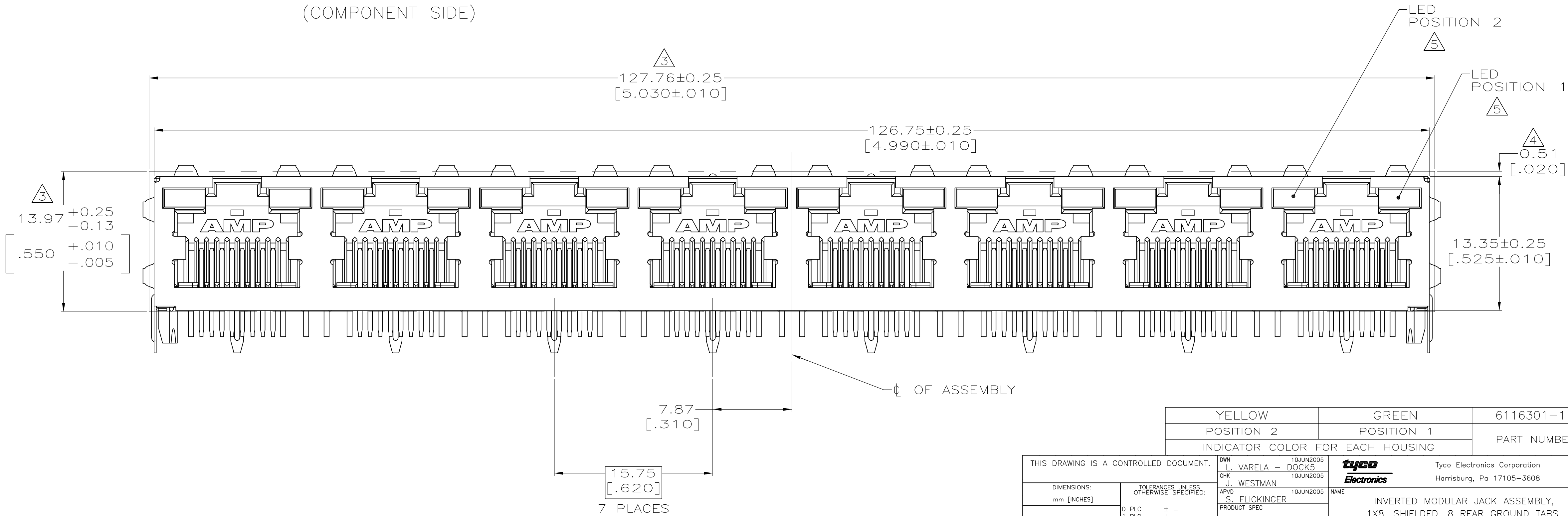
SHIELD - 0.196[.0077] THICK COPPER ZINC ALLOY PREPLATED WITH 1.27µm[.000050] MINIMUM SATIN NICKEL WITH 2.03µm[.000080] MINIMUM HOT TIN DIP ON PCB GROUND TABS.

LIGHT EMITTING DIODE (LED) - DIFFUSED EPOXY LENS, 0.51 x 0.51[.020 x .020] CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PREPLATED WITH 8.89 µm[.0003500] THICK Sn/Cu OVER 2.03 µm[.000080] THICK Ag OVER 1.02µm[.000040] THICK Cu OVER 3.56 µm[.000140] THICK Ni OVER 1.02µm[.000040] Cu UNDERPLATE

2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.
3. SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS.
4. SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR AND TOP PANEL OPENING.
5. SEE TABLE FOR COLOR OF LEDS AND NUMBER REQUIRED.
6. THIS MODULAR JACK WITH INTEGRATED LED IS NOT IR REFLOW SOLDERING PROCESS COMPATIBLE.



SUGGESTED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



YELLOW		GREEN		6116301-1	
POSITION 2		POSITION 1		PART NUMBER	
INDICATOR COLOR FOR EACH HOUSING					
DOCUMENT.		OWN L. VARELA - DOCKS 10JUN2005 CHK J. WESTMAN 10JUN2005 APVD S. FLICKINGER 10JUN2005		Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
SPEC. UNLESS SPECIFIED:		NAME		INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY, 1X8, SHIELDED, 8 REAR GROUND TABS, PANEL GROUND, LED	
+ - + - + 0.25(,01) + 0.13(,005) + -		PRODUCT SPEC 108-1163-4 APPLICATION SPEC 114-2154		RESTRICTED TO	
WEIGHT		SIZE		CAGE CODE	
A1		00779		DRAWING NO	
CUSTOMER DRAWING		C=6116301		SCALE	
1:1		SHEET		1 OF 1	
REV		A			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9